

Wechselwirkungen zwischen Metallisierungsmaske und Elektrolyt bei der selektiven außenstromlosen Goldabscheidung auf Leiterplatten



Rating: Not Rated Yet

Price

Price with discount: 1,78 €

1,78 €

Sales price without tax: 1,78 €

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Description 1 Einleitung Eine Vielzahl von Anwendungen in der Leiterplattenfertigung ist mit galvanischen Verfahren nicht zu realisieren, weswegen stromlose Abscheidungsverfahren an Bedeutung zu- nehmen. Die Selektivität des Verfahrens, die in erster Linie aus Kostengründen angestrebt wird, bedingt den Einsatz entsprechender Metallisierungsmasken. Zur stromlosen Selektivvergoldung von Kupferleiterbahnen (Drahtbondinseln usw.) sind in Abhängigkeit vom verwendeten Maskenmaterial zwei prinzipielle Varianten zu unterscheiden (Abb. 1). Die Verwendung einer temporären Maske ist dabei nur bei verhältnis- mäßig geringer Cu-Dicke möglich. Jedoch werden aus technologischer Sicht Lötstoppresiste die am häufigsten verwendeten Masken darstellen. Galvanoresiste bilden also nur einen Randbereich für spezielle Anwendungen. NiP dient in beiden Fällen als Diffusions- sperre gegenüber Kupfer.